

ECOCLEAN

technology that inspires

Solutions de nettoyage pour Composants de haute pureté

les exigences de propreté les plus élevées



SBS ECOCLEAN GROUP

ECOCLEAN UCM MHITRAA



En bref

PIÈCES ET COMPOSANTS

- Composants pour la lithographie EUV et DUV
- Scanner
- Systèmes de dépôt
- Pompes et vannes à vide poussées
- Composants pour lasers haute puissance (Haute puissance à ultra courte longueur d'onde)
- Composants pour les systèmes de mesure et d'analyse haute puissance (chromatographes en phase gazeuse, microscopes à balayage électronique, spectromètres de masse, etc)

EXIGENCES (GRADES I-IV)

- Général : exempt d'agents de traitement, exempt de taches
- Exigences particulières dans la gamme μ ou en dessous
- Valeurs limites extrêmes en ce qui concerne les matières organiques résiduelles ou de l'humidité résiduelle
- Limites atomiques/moléculaires

Nettoyage de Composants de haute pureté

Le nettoyage de composants sous vide poussé (UHV, XHV, UCV) dans l'industrie des semi-conducteurs (technologie EUV et DUV), les solutions technologiques sous vide pour la science, la recherche ou encore les systèmes laser de haute puissance, imposent des exigences extrêmement élevées en matière de propreté des composants utilisés. Pour cela, Ecoclean développe et fabrique des solutions de nettoyage adaptées de manière optimale au process. Cela permet de garantir aux industries de Haute-Technologies que les niveaux de propreté requis sont atteints de manière stable, durable et efficace.

Technologie du système :

- Systèmes de nettoyage aqueux, par exemple systèmes à simple et double chambres, systèmes à immersion
- Systèmes d'immersion à ultrasons comme solutions standard et solutions spéciales
- Systèmes de nettoyage aux solvants à chambre unique et à double chambre
- Systèmes spéciaux pour le nettoyage aqueux et par solvant, par exemple, de très grands composants
- Systèmes de nettoyage par pulvérisation
- Ingénierie de process, par ex. pulvérisation, immersion, Immersion sous pression, lavage par injection, nettoyage par ultrasons - également avec plusieurs fréquences -, nettoyage par ultrasons - également avec plusieurs fréquences -, nettoyage par ultrasons. ultrasons - également avec plusieurs fréquences, ultrasons plus, nettoyage par pression pulsée (PPC), plasma basse pression.
- Mouvement des charges, par exemple, rotation, pivotement, oscillation et mouvements de levage
- Séchage sous vide après nettoyage au solvant ou à l'eau, séchage à l'infrarouge et/ou séchage à l'air chaud haute pureté - également combiné avec séchage sous vide (aqueux)
- Traitement des médias adapté à la technologie de nettoyage, procédé, à la contamination, à l'exigence de propreté et débit, par exemple : distillation, évaporateur sous vide, ultrafiltration, système d'eau déminéralisée, système d'eau ultra-pure déminéralisée systèmes, osmose, solution de désalinisation.
- Automatisation partielle et complète, y compris le transport de marchandises via des convoyeurs à rouleaux, robots ou portique de chargement.

Concepts des solutions

Pré-nettoyage „sans huile ni graisse“

Nettoyage après usinage ou finition

- Huile, émulsion, particules, ...

➤ **Système de nettoyage de la chambre**
(solvants/aqueux)

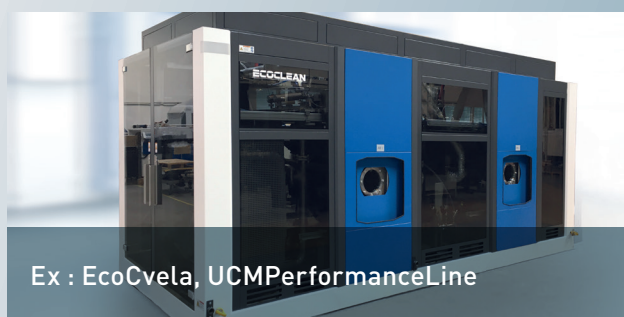


Nettoyage final

Après le pré-nettoyage

- Élimination des matières organiques résiduelles, particules et contamination atomique/ionique

➤ **Nettoyage de la chambre/**
Système d'immersion en ligne

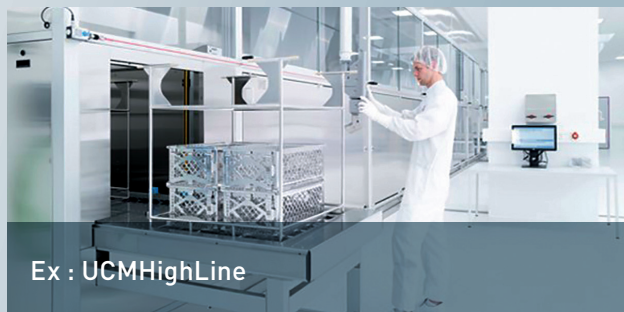


Nettoyage final

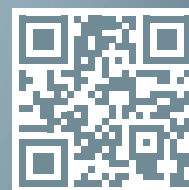
Après le pré-nettoyage

- Élimination des résidus organiques, des particules et de la contamination atomique/ionique

➤ **Solutions spéciales/**
Système d'immersion en ligne



Nos Sites dans le Monde



© SBS Ecoclean Group ▪ 02/2023 ▪ FR ▪ Sous réserve de modifications. La présente brochure contient des informations d'ordre général, les descriptifs et caractéristiques peuvent différer en fonction du cas concret d'application. Nous nous engageons sur les caractéristiques souhaitées une fois celles-ci convenues expressément à la signature du contrat.

SBS ECOCLEAN GROUP